

■ IEC 60519-1: 2020(電気加熱および電磁処理のための設備)の体系



1.適用範囲

・電気加熱および電磁処理のための設備

4. 機器と設備の分類と細分化

- 4.1 周波数による分類
- 4.2 電圧による分類
- 4.3 装置と設備の細分化
- 4.4 ハザードとリスクの分類

6.一般規定 6.5電源

- 7感電による危険からの保護
- 8電界または磁界による危険からの保護
- 9放射線による危険からの保護
- 10熱の影響による危険からの保護
- 11火災による危険からの保護
- 12液体による危険からの保護
- 13コンポーネントおよびサブアセンブリの特定の要件
- 14設備または機器の管理
- 15機械的危険に対する保護
- 16使用に起因する危険に対する保護
- 17 EMC

・付属書

- A(規範的) 重大な危険のリスト
- B(規範的) 接触電流の制限
- C(規範的) 非コヒーレント光放射-制限とリスククラス
- D(規範的) 電界および磁界
- E(規定) 表面温度制限
- F(規範的) EH、EPMおよび火災
- G(規範的) マーキングと警告
- H(参考) このドキュメントの使用に関するガイドライン
- I(参考) ISO 13577との接続(すべての部品)

- 2.引用規格
- 3.用語及び定義
- 5.リスク評価: 附属書A

18検証と試験

- 18.1一般
- 18.2測定とテストの実行
- 18.3参照からの要件の検証
- 18.4図面または計算の検討
- 18.5目視検査
- 18.6測定
 - 18.6.1処理装置内の環境と動作条件
 - 18.6.2保護ボンディングのインピーダンス
 - 18.6.3絶縁抵抗測定
 - 18.6.4電界または磁界の測定
 - 18.6.5タッチ電流測定
 - 18.6.6電離放射線の測定
 - 18.6.7非コヒーレント光照射の測定
 - 18.6.8コヒーレント光放射の測定
 - 18.6.9表面温度測定
 - 18.6.10熱にさらされる構造部品の温度
- 18.7機能テスト
 - 18.7.1電源の自動切断による保護
 - 18.7.2電圧テスト
 - 18.7.3誘電試験
 - 18.7.4充電部のアクセシビリティ
 - 18.7.5保護装置およびシステム
- 18.8数値計算とモデリング
 - 18.8.1一般
 - 18.8.2短絡電流の数値評価
 - 18.8.3電界または磁気放射の数値評価
 - 18.8.4光放射放出の数値評価

19使用情報

- 19.1一般要件
- 19.2使用する情報の場所と性質
- 19.3信号および警告装置
- 19.4マーキング、絵文字、書面による警告
- 19.5取扱説明書